

为服务器提供可靠、通过验证的材料

PCBA 材料

主板

- Durafuse® LT 低温高可靠性合金
 - TCT温循性能优于SAC305
 - 应对不同尺寸元件温度梯级过大的挑战
 - 抗跌落特性优于钎基低温合金两个数量级以上
- Solder Fortification® 预成型焊片
 - 精确增加焊锡量，提高机械可靠性
- 波峰焊助焊剂
 - WF-7745 无VOC 助焊剂
 - WF-9945 松香型助焊剂

内存模块

- Durafuse® HR
 - 增强TCT温循可靠性
 - 优异的低空洞表现
- Durafuse® LT 低温高可靠性合金
 - 增强TCT温循可靠性
 - 提升抗跌落能力

显卡

- Durafuse® LT 低温高可靠性合金
 - 增强TCT温循可靠性
 - 提升抗跌落能力
 - 减少芯片高温变形造成的焊接问题

散热器

- Heat-Spring® HSK
 - 为热源和散热器之间提供一个可压缩的界面，无需回流
 - 高导热性
 - 卓越的热循环性能

功率器件

- LV2K 预涂布助焊剂焊片
 - 减少接地焊盘空洞
 - 更少助焊剂残留，提高SIR测试性能

TIM1

- 焊接型导热界面材料
- 液态金属
- 相变合金

连接器

- Solder Fortification® 预成型焊片
 - 精确增加焊料量以提高机械可靠性

工程焊料

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

所有镭泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
镭泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2025 镭泰公司



表格编号: 100099 (SC) R1


INDIUM
CORPORATION®
镭泰公司